



2018년 12월 첫째주

# 해외 ICT 표준화 동향

## 목 차

본문            1. ETSI, 차세대 IP 프로토콜에 대한 규격 및 보고서 발표

기타  
소식            1. JEDEC, 전자 부품 표준 3D 모델 구현

※ 게시물 보기

TTA 홈페이지 ▷ 자료마당 ▷ TTA 간행물 ▷ 표준화 이슈 및 해외 동향

# 1. ETSI, 차세대 IP 프로토콜에 대한 규격 및 보고서 발표

ETSI, releases specification and reports on next generation IP Protocols

---

보도날짜 18. 11. 27.

출 처 ETSI

사 이 트 <https://www.etsi.org/news-events/news/1361-etsi-releases-specification-and-reports-on-next-generation-ip-protocols>

- ◆ 2018년 11월 27일, ETSI 차세대 프로토콜(Next Generation Protocol, NGP) 산업 규격그룹(Industry Specification Group, ISG)은 차세대 IP 프로토콜과 관련된 새로운 규격(Group Specification, GS) 및 보고서(Group Report, GR) 발표
  - ETSI GS NGP 013 : 사용자 평면 및 패킷 형식 및 전달 메커니즘에서 효율적인 결정적 패킷 전달(Flexilink: an efficient deterministic packet forwarding in user plane as well as packet formats and forwarding mechanisms)
  - ETSI GR NGP 010 v1.1.1 : 새로운 전송 기술에 대한 권장사항(Recommendation for New Transport Technologies)
  - ETSI GR NGP 011 v1.1.1 : 앤드 투 앤드 네트워크 슬라이싱 참조 프레임워크 및 정보 모델(E2E Network Slicing Reference Framework and Information Model)
- ◆ 네트워크 슬라이싱 또는 초고신뢰 저지연 통신(ultra-reliable low latency communication, URLLC)과 같이 5G에 제안된 새로운 서비스의 성능, 효율성 및 확장성을 최적화하기 위한 내용을 담고 있음
  - ETSI GS NGP 013는 ETSI GS NGP 012[i.3]에 문서화된 요구 사항과 GR NGP 003[i.2]과 같은 ETSI의 기술을 기반으로 5G 코어 및 액세스 네트워크에 대한 사용자 평면 패킷 형식과 라우팅 메커니즘을 지정함
  - ETSI GR NGP 010 v1.1.1 보고서는 5G와 그 이상의 차세대 아키텍처와 관련된 새로운 전송 기술에 중점을 두고 있으며 슬라이싱을 구현하는 고급 기능과 메커니즘에 대해 설명하고 보안 고려 사항을 다룸
  - ETSI GR NGP 011 보고서는 여러 관리 및 기술 영역에서 자원 보장 멀티테넌시(Multi-tenancy)<sup>1)</sup>를 제공하기 위해 네트워크 조각(Slice)에서 사용하는 리소스의 정보 규격을 설명

---

1) 멀티테넌시, Multitenancy : 모든 사용자가 웹을 통해 단일 데이터베이스 안의 정보를 관리하고 공유할 수 있게 하는 기능. [TTA 정보통신용어사전 참고 [http://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word\\_seq=049806-1](http://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=049806-1)]

## 기타 소식

### 1. JEDEC, 전자 부품 표준 3D 모델 구현

- ▷ 발 행 일 : 2018. 11. 27
- ▷ 원문제목 : JEDEC to Enable Standard 3D Models of Electronic Components
- ▷ 원 문 : <https://www.jedec.org/news/pressreleases/jedec-enable-standard-3d-models-electronic-components>
- ▷ 내용요약
  - 2018년 11월 27일, JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council, 솔리드 스테이트 기술 협회) JC-11 Mechanical Standardization Committee(기계 표준 위원회)는 새로운 표준모듈, 패키지, 소켓 외형에 대한 전자 부품 표준의 3D 모델을 출시할 예정이라고 발표함
  - 3D CAD 모델은 위원회에서 제공하는 2차원 기계 도면의 3차원 표현이며 업계에서 사용되는 가장 일반적인 3D CAD 소프트웨어 패키지로 가져올 수 있도록 표준 범용 형식으로 제공